



2021年3月10日

各 位

会 社 名 白 銅 株 式 会 社  
 代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 角 田 浩 司  
 役 職 氏 名  
 (コード番号：7637 東証第一部)  
 問 合 せ 先 管 理 本 部 長 谷 口 彰 洋  
 責 任 者  
 電 話 番 号 0 3 ( 6 2 1 2 ) 2 8 1 1

## 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、2020年5月13日に公表した業績予想および配当予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

## 記

## 1. 当期の連結業績予想数値の修正 (2020年4月1日～2021年3月31日)

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	親会社株主に 帰属する 当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益 (円 銭)
前回発表予想 (A)	39,000	1,500	1,560	1,070	94.34
今回修正予想 (B)	39,000	1,910	2,000	1,240	109.33
増減額 (B-A)	0	410	440	170	
増減率	0.0%	27.3%	28.2%	15.9%	
(ご参考) 前期実績 (2020年3月期)	41,798	1,658	1,697	1,148	101.27

## 2. 当期の個別業績予想数値の修正 (2020年4月1日～2021年3月31日)

	売上高 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益 (円 銭)
前回発表予想 (A)	36,700	1,470	1,000	88.17
今回修正予想 (B)	36,800	1,940	1,200	105.80
増減額 (B-A)	100	470	200	
増減率	0.3%	32.0%	20.0%	
(ご参考) 前期実績 (2020年3月期)	39,345	1,748	1,195	105.45

### 3. 業績予想修正の理由

当第2四半期までは、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等により業績が計画を下回っておりましたが、第3四半期以降はIoT、AI、5G等の情報通信技術の用途拡大に伴う半導体需要増を背景に半導体製造装置市場の拡大および原材料市況の上昇により、前回予想を上回る見通しとなったことから、2020年5月13日に公表いたしました通期の業績予想を修正いたします。

### 4. 配当予想の修正について

	年間配当金				
	第1 四半期末	第2 四半期末	第3 四半期末	期末	合計
前回予想 (2020年5月13日発表)	円 銭 -	円 銭 /	円 銭 -	円 銭 38.00	円 銭 38.00
今回修正予想	-	/	-	44.00	44.00
当期実績	-	0.00	-	/	/
前期実績 (2020年3月期)	-	0.00	-	58.00	58.00

### 5. 配当予想修正の理由

2021年3月期（2020年4月1日～2021年3月31日）の業績予想の修正を踏まえ、当期末の1株当たり配当金を前回予想の38円から6円増額の44円とすることといたします。

#### (将来に関する記述等についてのご注意)

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

以上